

## 锦州神工半导体股份有限公司

### 2024 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

#### 一、2024 年度主要财务数据和指标

单位：万元 币别：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	30,270.01	13,503.32	124.17
营业利润	5,215.72	-9,089.46	不适用
利润总额	5,226.36	-9,087.44	不适用
归属于母公司所有者的净利润	4,136.39	-6,910.98	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,885.61	-7,155.53	不适用
基本每股收益（元）	0.24	-0.43	不适用
加权平均净资产收益率	0.02	-4.31	增加 4.33 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	198,877.98	193,342.24	2.86
归属于母公司的所有者权益	179,317.46	176,179.46	1.78

股本（万股）	17,030.57	17,030.57	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.53	10.34	1.78

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2024 年度报告为准。数据若有尾数差，为四舍五入所致。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2024 年公司实现营业总收入 30,270.01 万元，同比增长 124.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,136.39 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,885.61 万元，实现扭亏为盈。

报告期末，公司总资产 198,877.98 万元，同比增长 2.86%；归属于母公司的所有者权益 179,317.46 万元，同比增长 1.78%；归属于母公司所有者的每股净资产 10.53 元，同比增长 1.78%。

报告期内，公司抓住大直径硅材料下游市场需求回暖以及硅零部件新增需求提升的契机，调整产品结构，营业收入和净利润较去年同期实现较大幅度增长。

### （二）上表中有关项目增减变动幅度达到 30% 以上的变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）	变动原因
营业总收入	30,270.01	13,503.32	124.17	报告期内，公司抓住大直径硅材料下游市场需求回暖以及硅零部件新增需求提升的契机，调整产品结构，营业收入和净利润较去年同期实现较大幅度增长。
营业利润	5,215.72	-9,089.46	不适用	
利润总额	5,226.36	-9,087.44	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	4,136.39	-6,910.98	不适用	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,885.61	-7,155.53	不适用	
基本每股收益（元）	0.24	-0.43	不适用	
加权平均净资产收益率	0.02	-4.31	增加 4.33 个百分点	

## 三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025年2月22日